

「SEMICON Japan 2017」は終了しました。ご来場ありがとうございました。

2017年12月13日（水）～12月15日（金）東京ビッグサイトにて開催の『SEMICON Japan 2017』に出展いたします。

是非この機会に弊社ブースをご来訪いただき、アライドマテリアルを情報交換の場・問題解決の場としてご利用ください。

◆日 時 : 2017年12月13日（水）～12月15日（金）午前10：00～午後5：00

◆場 所 : 東京ビッグサイト 東展示場

◆弊社ブース : 東2ホール 2237（後工程・総合・材料ゾーン）

◆主な展示製品：

【ダイヤモンド工具】

（研削工具関係）

Si、SiC、GaN、LT結晶ウェーハの高効率加工工具「ナノメイトプレミアム」

高効率は勿論、低ダメージで、後工程であるCMP工程の負担軽減を提案いたします。

（切断工具関係）

高剛性ボディ切断ホイール、スモールソー、超硬合金製高精度薄刃（Gカッター）など

切断工具をご紹介

（塑性工具関係）

ボンディング線ほか、各種線の伸線用ダイヤモンドダイスをご紹介

【高性能ヒートシンク材料】

次世代IGBT用ヒートシンク新材料「Mg-SiC」や、「Cu-Mo」材料をご紹介

※ 『SEMICON Japan 2017』の概要は、主催者のオフィシャルホームページをご覧ください

→ <http://www.semiconjapan.org/>